

智慧電子人才應用發展推動計畫 111 年度中長期養成班入選班級

◎正取班級

序號	開班單位(依筆劃排序)	課程名稱	政府經費 ¹² (元)
1	中華大學學校財團法人中華大學	IC 應用工程師人才養成班	600,000
2	中華大學學校財團法人中華大學	中華大學先進製程積體電路佈局工程師人才養成班	1,000,000
3	中華行動數位科技有限公司	中華行動數位嵌入式 AI 應用人才養成班	800,000
4	中華行動數位科技有限公司	中華行動數位嵌入式韌體工程師人才養成班	600,000
5	台灣車用電子協會	車載系統可靠度驗證測試人才養成班	959,400
6	正修科技大學	IC 封裝與測試設備工程師人才養成班	720,000
7	艾錡科技有限公司	生醫訊號處理工程師人才養成班	800,000
8	明新科技大學	明新 IC 封裝工程師養成班	600,000
12	國立高雄大學	高雄大學先進製程整合封裝設備人才養成班	600,000
13	國立高雄科技大學	半導體製程人才實務技能養成班	840,000
14	國立臺灣科技大學	臺科晶片佈局人才養成班	600,000
15	崑山科技大學	崑大半導體封裝製程設備工程師養成班	720,000
16	崑山科技大學	崑大 IC 封裝設備工程師養成班	720,000
17	資展國際股份有限公司	AI 與深度學習應用工程師就業養成班	900,000

¹ 政府經費以每班 20 人編列，實際執行金額依符合結訓認列學員人數撥付。

² 為平衡台灣半導體產業聚落發展，授課地點於南部地區者，政府經費以 60% 為上限編列。

◎備取班級³

序號	開班單位(依筆劃排序)	課程名稱	政府經費 ¹² (元)
1	中原大學	中原大學測試工程師人才養成班	600,000
2	艾錡科技有限公司	AI 與深度學習應用工程師人才養成班	600,000
3	國立高雄科技大學	半導體封裝工程師人才養成班	720,000
4	義守大學	半導體先進製程設備整合人才養成班	600,000
5	資展國際股份有限公司	嵌入式軟韌智慧系統創新應用就業養成班	1,500,000

³ 備取班級將視整體開班狀況及經費運用情形，由計畫辦公室另行通知開班單位遞補開班及招生。